

概 要

本概要旨在向閣下提供本文件所載資料的概覽。由於僅為概要，故並未載列所有可能對閣下而言屬重要的資料。閣下在決定[編纂]於[編纂]前，應細閱整份本文件。任何[編纂]均涉及風險。[編纂]於[編纂]的部分特定風險載於「風險因素」。閣下在決定[編纂]於[編纂]前，應細閱該節。

概覽

我們是誰

我們是一家平台型無晶圓廠半導體公司，致力為橫跨端側、邊緣及雲端的廣泛AI應用賦能。我們已構建一個以多製式蜂窩基帶技術、AI計算技術及複雜SoC設計能力為支撐的集成技術平台。根據弗若斯特沙利文的資料，我們是全球極少數在集成技術平台上同時具備這三大核心能力的半導體公司之一。我們的平台支撐三大協同業務：以蜂窩連接為核心的無線連接芯片、智能SoC及ASIC定制解決方案，使我們能夠滿足客戶在AI時代快速變化的需求。作為全球蜂窩連接芯片行業公認的市場領導者，我們的業務規模及市場地位印證了我們在多元應用場景中將高複雜性集成電路設計技術商業化的能力，為我們將平台延伸至AI賦能的應用領域奠定了堅實基礎。於2025年，我們按出貨量計在全球蜂窩連接芯片市場排名第一，市場份額為37.8%；我們於2023年至2025年間的出貨量增長率亦超過其他全球前五的同類企業。

隨着AI進入大規模部署的新時代，各類應用日益需要將高效計算與無處不在、隨時隨地的連接相結合，以實現端側、邊緣及雲端之間的實時數據傳輸、計算任務協同及算力流動。在各類無線通信技術中，蜂窩技術（尤其是5G及新興的6G標準）在提供連續、廣域及支持移動性的連接方面具有不可替代性。例如，智能網聯汽車在跨地點移動時，需要與雲端實時交換路況、危險預警及傳感器數據，僅靠固定的Wi-Fi熱點無法可靠支持這一使用場景。唯有蜂窩網絡提供連續覆蓋及跨基站間的無縫切換，才使得設備在移動中保持連接。掌握蜂窩基帶技術難度極高，需要具備跨越多代蜂窩標準的深厚技術積累、複雜的軟硬件協同設計、大量的兼容性測試及認證，以及對性能、功耗及成本的持續優化。該等能力需要長期投入，並構成了重大的進入壁壘。

蜂窩基帶技術是我們技術平台的基石。自成立以來，我們已開發並商業化覆蓋2G至5G所有標準的歷代蜂窩產品，並藉此積累了複雜SoC設計能力，涵蓋芯片架構、超大規模數模混合芯片設計、軟硬件協同設計、系統集成以及性能、功耗和成本優化。我們亦自主開發了AI計算技術，包括自研的神經網絡處理單元(NPU)，可實現兼具強勁性能與能效的端側AI處理。蜂窩基帶技術、AI計算技術及複雜SoC設計能力的結合，使我們能夠把握橫跨端側、邊緣及雲端場景的AI芯片市場機遇。憑藉該等能力，我們為智能端側應用開發了智能SoC-ASR 7801及ASR8861，每款產品均集成我們自研的NPU，具備端側AI算力。我們亦向超大規模雲服務商、領先的AI企業及半導體公司提供ASIC定制解決方案，涵蓋雲端推理、邊緣／端側AI、RISC-V及企業級存儲等領域。截至2026年6月30日，我們已成功交付數十個ASIC定制項目，其中包括採用4nm先進制程的芯片設計。

概 要

我們的集成技術平台在自有品牌產品與ASIC定制解決方案之間形成了自我強化的商業模式。與主要專注於獨立芯片產品或ASIC服務的公司不同，我們受益於產品商業化與定制芯片設計之間的協同作用。自有品牌無線連接芯片及智能SoC的量產持續驗證並優化我們的複雜SoC IP、設計方法論及全生命週期交付能力，該等能力繼而可復用於ASIC定制解決方案。反過來，ASIC定制解決方案將我們的能力延伸至先進製程、複雜芯片架構及新興應用領域，為未來的產品及項目積累專有技術。這種飛輪效應提升了我們的創新效率、交付確定性及商業化能力，使我們能夠把握橫跨端側、邊緣及雲端的更廣闊AI芯片市場機遇。

下圖載列我們的主要市場地位及財務亮點：



- (1) 根據弗若斯特沙利文的資料。
- (2) 按全球市場蜂窩連接芯片2025年出貨量計算。
- (3) 就2023年至2025年的出貨量增長率而言。
- (4) 按全球市場4G蜂窩連接芯片2025年出貨量計算。
- (5) 截至2026年6月30日。
- (6) 由截至2025年6月30日的在手訂單量至截至2026年6月30日的在手訂單量。

我們的市場機遇

AI正進入一個聚焦實際場景部署與生產力提升的新階段。隨着AI從雲端延伸至端側、車輛、機器、機器人及其他物理世界應用，其日益需要連接與計算的緊密協同。數據、計算任務及智能必須在端側、邊緣及雲端之間以低時延、高可靠性及高能效高效流轉，這正為連接芯片、智能SoC及ASIC定制解決方案帶來結構性增長機遇。在此背景下，蜂窩基帶技術

概 要

及端側AI計算已成為從端到雲應用場景中部署人工智能的兩大關鍵技術基礎，提供無處不在、低時延及高能效的連接。

儘管人工智能是驅動技術，但連接已成為其部署不可或缺的部分。AI應用需要在端側、邊緣節點及雲基礎設施之間加強數據及計算任務的傳輸，尤其是在移動、廣域及大規模場景中。蜂窩技術（尤其是5G及向6G的演進）在實現無所不在、隨時隨地的連接方面具有不可替代性，具備移動性支持、廣域覆蓋、高帶寬、低時延及大規模連接密度等特性。這預計將推動不同代際及應用場景對蜂窩連接芯片的需求。根據弗若斯特沙利文的資料，全球蜂窩連接芯片出貨量預計將由2026年的914.4百萬增加至2030年的1,797.4百萬，年複合增長率為18.4%。

AI亦推動對功能更強大的智能SoC的需求。在終端智能化趨勢下，芯片必須在嚴格的功耗、成本及外形尺寸限制下，集成應用處理、連接、多媒體、感測及人工智能計算。這提升了對高性能計算、高能效及高系統級集成度的SoC的需求。根據弗若斯特沙利文的資料，全球智能SoC市場預計將由2026年的909億美元增長至2030年的1,713億美元，年複合增長率為17.2%，其中AI細分市場預計將由2026年的627億美元增長至2030年的1,510億美元，年複合增長率為24.6%。

ASIC定制解決方案是上述三個市場中增長最快的領域，對我們而言是一項重大機遇。隨着AI應用日益專用化及技術日趨複雜，市場對ASIC定制解決方案的需求正在不斷擴大。從雲端推理和端側AI到企業存儲及定制化端側級芯片，客戶日益需要針對特定應用而設計，並在性能、功耗、成本及時延方面實現優化的專用芯片。隨着芯片設計複雜性不斷提升，能夠有效將應用需求轉化為優化芯片設計的公司，將有望把握這一趨勢。根據弗若斯特沙利文的資料，全球ASIC定制解決方案市場預計將由2026年的1,005億美元增長至2030年的2,355億美元，年複合增長率為23.7%，其中人工智能細分市場預計將由2026年的584億美元增長至2030年的1,785億美元，年複合增長率為32.2%。

我們是全球極少數處於這三大機遇交匯點的半導體公司之一。憑藉集成技術平台及涵蓋無線連接芯片、智能SoC和ASIC定制解決方案的協同產品組合，我們相信自身已準備好把握人工智能驅動的端側、邊緣及雲端連接與計算的增長。

透過集成平台與產品服務，實現AI從端到雲規模化擴展

我們的集成技術平台

隨着AI在端側、邊緣與雲端的廣泛應用，芯片需要提供的能力已不僅僅是算力。在時延、功耗、成本及外型尺寸等各類限制下，芯片必須兼顧性能、能效、連接、整合能力與開發彈性。我們深信，在AI時代，以下能力對芯片解決方案而言日益關鍵：

- **高性能與低功耗。** AI賦能的芯片必須在嚴格的功耗和散熱限制下輸出充足算力，這對於電池供電以及成本敏感的端側設備尤為重要。軟硬件協同優化與高效的工作負載分配，是提供可靠AI，並在端側、邊緣節點和雲端基礎設施間協同任務調度的核心關鍵。

概 要

- **高集成度。**AI賦能的芯片正日益集成連接、計算、傳感、多媒體處理及其它系統功能。更高的集成度減少了外部組件、簡化了系統設計，提高了功耗和面積效率，可實現更小的產品外形尺寸及更低的系統成本。
- **高複用性與可配置性。**隨着AI應用場景的多元化，芯片方案必須能夠適配多樣化的標準、AI模型、操作系統、硬件環境和性能要求。可復用架構、模塊化IP和軟件框架能夠提高開發效率，加速產品在端側、邊緣及雲端場景中實現商業化。

我們的集成技術平台使我們能夠高效地開發芯片並實現商業化，橫跨多種產品、項目和應用場景。我們無需從零開始研發每款新芯片，而是將我們的技術、專有知識產權、設計方法以及執行能力複用並適配到自有品牌產品和ASIC定制解決方案中。這使我們能夠更高效和更可靠地將技術平台拓展至全新的通信標準、AI工作負載及終端市場。

基於此平台，我們面向從端到雲的AI應用，打造了三大協同增效的產品線：無線連接芯片為AI應用提供通信基礎；智能SoC集成了用於端側設備的數據處理、網絡連接、感知交互與端側智能，服務終端設備；而我們ASIC定制解決方案則將我們的平台應用於端側和雲端的專用計算。

下圖展示了我們的核心技術如何轉化為自有品牌產品和ASIC定制解決方案，以及它們所服務的應用與終端市場：



我們持續投入研發，構建了貫穿所有自有品牌產品和ASIC定制解決方案的集成技術平台。該平台基於三大核心支柱：

- **多製式蜂窩基帶技術。**我們擁有涵蓋2G至5G所有標準的端到端蜂窩連接能力，包括協議棧、基帶和射頻技術，以及完整的蜂窩芯片開發。蜂窩網絡獨特地融合了廣域覆蓋、無縫移動性、可預測的時延和可靠性，以及對海量連接的支持，為移動、廣域和關鍵任務型的AI應用提供了通信基礎。我們的5G網絡切片技術進一步實現了對時延、帶寬和可靠性的差異化控制。我們的Wi-Fi、藍牙、LoRa、GNSS和衛星通信技術與蜂窩網絡能力相輔相成，拓展了我們服務的應用範圍。

概 要

- **AI計算技術。**在端側，我們自主研發的NPU架構支持主流AI模型，算力可在0.2 TOPS至數百TOPS間靈活擴展，支持端側生成式AI、實時語音翻譯、視頻增強和其他本地AI推理任務。在雲端，我們的大規模異構AI芯片設計技術支持開發複雜的AI ASIC和雲計算芯片，這些芯片集成了數百億個晶體管，可用於大模型的訓練和推理。此外，AI大模型端雲協同/異構算力調度技術，進一步協同調度了跨端側、邊緣節點與雲端基礎設施的AI工作負載。
- **複雜SoC設計能力。**智能SoC必須在單個芯片上集成多種功能，包括處理、存儲、高速接口、圖形和顯示、傳感、安全和電源管理等。利用我們超大規模數模混合芯片設計技術以及多模態感知和處理技術，我們能夠在兼顧性能、功耗、芯片面積和成本的同時，將這些功能設計和集成到複雜的SoC中，從而確保我們的產品在大眾市場應用中的商業可行性。

隨着我們的大規模芯片出貨，我們已掌握貫穿芯片開發全生命週期的端到端設計、生產和供應鏈能力，涵蓋芯片定義和架構設計、前端和後端設計、驗證、流片、晶圓代工廠與OSAT協同、量產爬坡、質量管理和成本控制的全流程。這些能力使我們能夠將複雜的設計轉化為可靠的、可批量生產的芯片。在我們的ASIC定制解決方案中，這些能力還使我們能夠為客戶提供從芯片定義和設計到批量生產的一站式支持。我們龐大的商業化出貨規模持續對這些能力進行壓力測試、驗證和改進，從而積累了實用的設計、製造和供應鏈經驗。我們相信，對於缺乏類似批量生產經驗的同行而言，這些經驗難以複製。

我們相信，我們在蜂窩物聯網領域成功積累的商業化能力與端側AI和邊緣AI應用場景高度契合。這兩個市場都具有應用場景分散且多樣化、長尾客戶需求以及對能效、成本優化、快速產品迭代和長期技術支持等諸多嚴格要求的共同特點。這些市場的客戶通常擁有較長的認證週期，並且重視擁有成熟產品能力、穩定交付和穩固服務關係的供應商。憑藉我們在連接芯片領域的經驗以及與下游客戶的良好關係，我們有能力將產品線擴展到AI SoC領域，因為客戶可能更傾向於向那些已經為其端側提供連接基礎架構的供應商採購端側AI芯片。

我們的產品與服務

我們打造了三大具有協同效應的業務線，旨在把握人工智能時代帶來的機遇。我們的無線連接芯片為互聯端側的發展奠定了堅實的商業基礎，並支持其廣泛應用。我們的智能SoC將我們的能力擴展到集成端側智能設備領域，而我們的ASIC定制解決方案則使我們能夠滿足端側和雲端的特定應用計算需求。這些產品和服務將成熟的商業化模式與高增長的人工智能機遇相結合，而這一切都基於我們的集成技術平台。

無線連接芯片－互聯AI的堅實基礎。我們提供涵蓋從2G到5G所有標準的廣泛蜂窩連接芯片產品組合，包括5G NR及RedCap。我們的產品主要用於蜂窩物聯網和移動寬帶應用，例如移動寬帶終端、工業和商業物聯網、聯網汽車、可穿戴設備和智能金融終端。這使端邊雲之間的無處不在、實時且海量的連接得以實現。根據弗若斯特沙利文的報告，截至2025年，我們是極少數有能力自主研發涵蓋2G至5G全制式蜂窩連接芯片並實現大規模量產的中國本土供應商之一，亦是全球極少數實現核心技術路徑與應用場景全覆蓋的供應商之一。

概 要

我們的蜂窩產品已被國內外領先的模組製造商和設備製造商廣泛採用，並已通過全球前五大電信運營商中四家的認證，這是在其網絡上進行商業部署的先決條件。據弗若斯特沙利文統計，在2025年，我們在蜂窩連接芯片市場的出貨量位居全球第一；在4G蜂窩連接芯片、Cat.1芯片以及Cat.4芯片領域，出貨量同樣位居全球榜首。根據弗若斯特沙利文的資料，我們在眾多下游應用細分領域的出貨量亦位居全球榜首，包括移動網關設備、智能可穿戴設備、智能電錶及智能電網。此外，我們的Wi-Fi、藍牙、LoRa與GNSS產品進一步拓寬了在短距離及其他特色連接場景的應用覆蓋。在2025年，自有品牌無線連接芯片全球出貨量突破3億顆。

智能SoC—端側集成智能。憑藉我們強大的SoC設計能力，我們提供的智能SoC集成了應用處理、連接、多媒體、傳感、安全和電源管理等功能。部分產品採用我們自主研發的NPU，實現高效的端側智能。我們具備開發算力範圍覆蓋0.2 TOPS至數百TOPS的高集成、低功耗產品能力，以滿足不同端側設備的需求。我們的智能SoC產品已通過商業驗證。例如，我們首款商用4G智能手機SoC—ASR8601，截至2026年6月30日累計出貨量已達約5.8百萬顆，驗證了其在運行Android平台時的效能及整體可靠性。此後，我們的產品線已從四核智能SoC發展到八核智能SoC，並集成端側AI。我們最新一代產品ASR7801及ASR8861均集成了自主研發的NPU，可提供高達20 TOPS的端側AI計算能力。ASR7801專為AI賦能的圖像處理、多媒體處理和其他端側AI應用而設計。ASR8861支持AI助手、端側大語言模型以及實時語音和文本翻譯，無需依賴雲處理即可實現實時AI響應。

ASIC定制解決方案—從端到雲的應用專用計算。在turnkey模式下，我們提供端到端的ASIC定制解決方案，並支持定制芯片的規模化量產。我們根據客戶的特定工作負載和性能、功耗、成本、時延和系統集成要求，量身定制芯片。我們的項目涵蓋AI計算、RISC-V、企業存儲、機器人視覺、智能穿戴及工業控制等，尤其擅長面向推理的ASIC。這一優勢可追溯至2018年，當時，在與多家國際知名芯片設計公司的激烈競標中，我們獲選為一家領先的AI企業開發超大規模雲端AI定制芯片。如今，我們的ASIC客戶涵蓋超大規模數據中心以及領先的人工智能和半導體公司。截至2026年6月30日，我們已成功交付數十個ASIC定制項目，其中包括採用4nm先進製程的芯片設計。根據弗若斯特沙利文公司的報告，在全球主要供應商中，我們在研發效率、應用場景與服務流程的全覆蓋度、平台化能力及先進製程（6nm及以下）在研項目佔比等方面均處於領先地位。

我們的成就

我們已實現顯著的商業化規模。2025年，我們自有品牌產品的全球出貨量突破3.3億顆，其中包括約29.3百萬顆智能SoC。截至2026年6月30日，我們的Cat.1、Cat.4和Cat.7芯片組的全球累計出貨量接近10億顆。據弗若斯特沙利文統計，截至2025年，全球前五大蜂窩模組廠商中有四家（包括所有前三大廠商）採用了我們的無線連接芯片。截至2026年6月30日，我們的產品已進入多家頭部終端客戶的供應鏈，覆蓋超過130個國家及地區。在我們的ASIC定制業務中，我們曾為對人工智能推理及其他人工智能相關芯片有需求的優質客戶提

概 要

供服務。我們的ASIC客戶包括位列中國十大人工智能芯片公司、五大全棧雲服務供應商及五大智能座艙芯片供應商的企業，以及全球五大XR設備廠商。截至2026年6月30日，ASIC定制解決方案的在手訂單金額超過人民幣15億元，較2025年6月30日增長416.5%。

在往績記錄期內，我們實現了顯著增長。我們的收入從2023年的人民幣2,599.9百萬元增長至2025年的人民幣3,816.8百萬元，年複合增長率達21.2%。我們的收入從截至2025年6月30日止六個月的人民幣1,898.1百萬元進一步增長至截至2026年6月30日止六個月的人民幣2,451.3百萬元，增幅達29.1%。我們的毛利從2023年的人民幣584.4百萬元增長至2025年的人民幣890.7百萬元，年複合增長率達23.5%。我們的毛利由截至2025年6月30日止六個月的人民幣405.9百萬元進一步增長至截至2026年6月30日止六個月的截至2026年6月30日止六個月的人民幣699.5百萬元，增幅達72.3%。此外，我們在截至2026年6月30日止六個月實現了扭虧為盈，錄得淨利潤人民幣84.2百萬元，而2025年同期則淨虧損人民幣245.4百萬元。

競爭優勢

我們相信以下競爭優勢造就了我們的成功，並使我們區別於競爭對手：(i)具備多製式蜂窩基帶及複雜SoC設計的獨特能力；(ii)基於自主研發且經批量生產驗證IP搭建的多功能整合平台；(iii)經量產及商業化成果驗證的高效研發能力；(iv)憑藉長期供應鏈合作關係，實現可靠的從設計到量產交付；以及(v)具遠見的領導層及經驗豐富的管理團隊。詳情請參閱「業務－競爭優勢」。

增長策略

我們擬推行以下策略，推動業務持續增長，進一步鞏固市場領導地位：(i)鞏固市場領導優勢，拓寬產品供應，把握從端到雲AI的發展機遇；(ii)擴展ASIC解決方案，抓住定制芯片日益增長的市場需求；(iii)推進研發工作，豐富IP組合，維持技術領先地位；(iv)依托現有客戶進一步開拓新市場，擴大境內外客戶群；(v)吸引及留用人才，強化創新內核；以及(vi)開展戰略投資與收購，拓展技術平台及生態系統。詳情請參閱「業務－增長策略」。

研究與開發

我們的研發活動支持三大技術支柱的發展，以及使用該等技術的自有品牌產品與ASIC定制解決方案。我們已進行並將繼續進行大量研發投入。於2023年、2024年、2025年及截至2026年6月30日止六個月，我們的研發費用分別為人民幣1,115.8百萬元、人民幣1,241.8百萬元、人民幣1,298.7百萬元和人民幣663.3百萬元，分別佔各期總收入的42.9%、36.7%、34.0%及27.1%。我們的研發能力由一支跨學科工程師團隊支撐。截至2026年6月30日，我們擁有1,180名研發人員，約佔員工總數的90%。約74.7%的研發人員擁有碩士及以上學位，其中包括23名博士。我們的團隊包括技術專家及資深工程師，彼等具備在全球領先無線通訊公司工作的經驗，並在系統架構、訊號處理、通訊協議棧以及數位、類比及射頻電路設計方面擁有專業知識。我們的研發組織將基礎技術的集中開發與產品特定開發相結合。功能團隊在數位、類比、射頻、軟件及驗證功能的支持下，開發並維護可重複使用的資產及方法論，涵蓋蜂窩基帶、AI運算及複雜SoC設計等領域。該等資產包括用於訊號處理、類比及射頻電路、協議棧及低功耗設計的IP，可於不同產品間重複使用。詳情請參閱「業務－研究與開發」。

概 要

銷售與營銷

我們透過直銷及經銷商渠道相結合的方式為客戶提供服務。我們的直接客戶主要包括(i)批量採購我們自有品牌產品的模組製造商及設備製造商，及(ii)我們ASIC定制解決方案的客戶。於2023年、2024年、2025年以及截至2025年及2026年6月30日止六個月，我們的直銷收入分別為人民幣463.3百萬元、人民幣593.5百萬元、人民幣658.7百萬元、人民幣356.0百萬元及人民幣535.2百萬元，分別佔我們相應期間總收入的17.8%、17.5%、17.3%、18.8%及21.9%。

我們亦透過經銷商（包括買斷式經銷安排及代理式經銷安排）銷售大部分自有品牌產品。我們聘用經銷商主要為有效地服務於廣泛應用領域中龐大且多元化的下游客戶基礎。根據弗若斯特沙利文的資料，聘用經銷商為供應蜂窩物聯網芯片的無晶圓廠半導體公司的常見做法。我們的大部分分銷銷售乃根據代理安排進行，據此，我們保留終端客戶開發及技術參與的主要責任。我們的銷售及技術團隊識別並接洽下游客戶，與其協定產品型號及定價，並直接提供技術支持，而經銷商則提供倉儲及庫存支持、安排交付及收取款項。我們其餘的分銷銷售為買斷式銷售，據此，經銷商購買我們的產品以轉售予其客戶並承擔相關存貨風險，而我們於向經銷商或其指定承運人交付產品時確認收入。截至2026年6月30日，我們透過銷售網絡委聘七名經銷商。於2023年、2024年、2025年以及截至2025年及2026年6月30日止六個月，我們的分銷收入分別為人民幣2,136.6百萬元、人民幣2,792.2百萬元、人民幣3,158.1百萬元、人民幣1,542.0百萬元及人民幣1,916.1百萬元，分別佔我們相應期間總收入的82.2%、82.5%、82.7%、81.2%及78.2%。有關詳情，請參閱「業務—銷售與營銷」。

我們的客戶及供應商

於往績記錄期間，我們自有品牌產品的客戶包括電子元件經銷商，以及直接銷售模式下的模組製造商及設備製造商。我們的ASIC定制解決方案客戶主要為互聯網、人工智能及半導體公司。於往績記錄期間各年度／期間，我們向五大客戶銷售產生的收入分別為人民幣2,083.6百萬元、人民幣2,780.6百萬元、人民幣3,150.9百萬元及人民幣1,957.8百萬元，分別佔我們相應年度／期間總收入的80.1%、82.1%、82.6%及79.9%。於往績記錄期間各年度／期間，我們向最大客戶銷售產生的收入分別為人民幣1,108.9百萬元、人民幣1,255.8百萬元、人民幣1,433.9百萬元及人民幣904.3百萬元，分別佔我們相應年度／期間總收入的42.7%、37.1%、37.6%及36.9%。有關詳情，請參閱「業務—我們的客戶」。

於往績記錄期間，我們的供應商主要包括晶圓代工廠及OSAT供應商，以及半導體產品及第三方半導體IP供應商。於往績記錄期間各年度／期間，我們向五大供應商的採購額分別達人民幣1,920.0百萬元、人民幣2,214.9百萬元、人民幣2,672.1百萬元及人民幣1,697.8百萬元，分別佔我們相應年度／期間採購總額的75.0%、77.6%、71.4%及74.8%。於往績記錄期間各年度／期間，我們向最大供應商的採購額分別達人民幣1,340.8百萬元、人民幣1,470.8百萬元、人民幣1,705.2百萬元及人民幣1,158.4百萬元，分別佔我們相應年度／期間採購總額的52.4%、51.5%、45.5%及51.1%。我們認為我們與主要供應商維持着良好的合作關係。供應商給予我們信貸期通常為30至60天，我們透過銀行轉賬向供應商支付到期款項。有關詳情，請參閱「業務—我們的供應鏈管理—我們的主要供應商」。

我們的供應鏈管理

作為一家無晶圓廠半導體公司，我們並不擁有晶圓製造、封裝或測試設施。我們的外包生產流程一般包括晶圓製造、凸塊加工、晶圓測試、封裝、最終測試及系統級測試。因此，我們的供應商主要包括代工廠（為我們製造晶圓）及OSAT供應商（為我們進行封裝及測試）。

概 要

兩者採購額合計佔我們的絕大部分採購。我們亦採購若干半導體產品，以及第三方半導體IP、設計軟件、設備及外包技術服務。我們就我們的自有品牌產品及ASIC定制解決方案採購晶圓製造以及封裝及測試服務，相關安排按有關產品或項目要求磋商釐定。我們就自有品牌產品及ASIC定制解決方案統一採購晶圓製造以及封裝及測試服務，商業條款於集團層面磋商釐定。整合兩項業務的需求可提升我們向製造合作夥伴的總採購量，有助我們獲得產能及具競爭力的商業條款，而個別安排仍會按照有關產品或項目要求作出調整。於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們並未因晶圓製造或封裝及測試服務的供應短缺或延遲而遭遇任何業務中斷，亦未遇到與任何主要供應商的關係被暫停或終止，或與供應商發生任何重大爭議。我們根據多項因素選擇及評估供應商，包括技術專業知識、產品質量及質量控制、價格、交付能力、服務及應對能力以及整體往績記錄。在接納新供應商之前，我們會審查其商業能力及背景，包括其法律資格、信貸及合規記錄以及與我們的任何關連關係。對於主要製造合作夥伴，我們亦會對其製造設施、質量體系及營運流程進行現場審查，並要求提供樣品，以供按照我們的技術規格進行測試。有關詳情，請參閱「業務—我們的供應鏈管理」。

競爭

我們所處的市場競爭激烈，既有成熟的國際參與者，亦有新興的本土企業。我們在主要產品及服務領域展開競爭，包括無線連接芯片、智能SoC及ASIC定制解決方案。主要競爭因素因產品及服務而異。我們相信，我們的競爭優勢建基於三大技術支柱的結合、可複用且經量產驗證的IP，以及我們將複雜芯片從設計、流片推進至量產的豐富經驗。我們將該等能力應用於自有品牌產品及ASIC定制解決方案，並協調相關的晶圓廠及OSAT資源。有關我們所處市場競爭格局的進一步資料，請參閱「行業概覽」。

風險因素

我們的業務及[編纂]涉及若干風險，該等風險載於本文件「風險因素」一節。我們面臨的部分主要風險包括：(i)激烈競爭及技術與行業標準的快速演變；(ii)半導體行業固有的週期性；(iii)我們對下游市場需求的依賴；(iv)未能以具成本效益的方式及時開發及商業化新產品或升級產品；(v)漫長且成本高昂的產品認證及驗證流程；(vi)漫長的產品開發及商業化週期帶來的收入不確定性及延遲；(vii)與我們ASIC定制解決方案相關的項目執行、客戶驗收及收入確認風險；(viii)大量研發開支及不確定的回報；(ix)我們對有限數量的第三方供應商提供關鍵產品及服務的依賴；及(x)對外包製造流程及生產進度的控制有限。詳情請參閱「風險因素」一節。

歷史財務資料概要

下表載列我們於所示期間的合併損益表概要。下文所載的我們的歷史業績未必反映我們未來任何期間可能取得的業績。下文所載的概要財務數據應與本文件所載合併財務報表（包括相關附註）一併閱讀，並以其整體內容為參照。我們的合併財務資料乃根據國際財務報告準則會計準則編製。

概 要

	截至12月31日止年度						截至6月30日止六個月			
	2023年		2024年		2025年		2025年		2026年	
	人民幣	%	人民幣	%	人民幣	%	人民幣	%	人民幣	%
	(以人民幣千元計，百分比除外)						(未經審計)		(未經審計)	
收入	2,599,916	100.0	3,385,743	100.0	3,816,803	100.0	1,898,066	100.0	2,451,275	100.0
銷售成本	(2,015,508)	(77.5)	(2,689,975)	(79.5)	(2,926,123)	(76.7)	(1,492,183)	(78.6)	(1,751,783)	(71.5)
毛利	584,408	22.5	695,768	20.5	890,680	23.3	405,883	21.4	699,492	28.5
銷售及營銷開支	(24,444)	(0.9)	(30,734)	(0.9)	(23,971)	(0.6)	(12,933)	(0.7)	(11,054)	(0.5)
行政開支	(131,669)	(5.1)	(140,600)	(4.2)	(144,732)	(3.8)	(77,719)	(4.1)	(64,341)	(2.6)
研發費用	(1,115,775)	(42.9)	(1,241,808)	(36.7)	(1,298,748)	(34.0)	(668,450)	(35.2)	(663,323)	(27.1)
金融資產及合約資產										
減值(虧損)/轉回淨額	(128)	(0.0)	(17,565)	(0.5)	3,455	0.1	(1,090)	(0.1)	(827)	(0.0)
其他收入	39,161	1.5	54,276	1.6	118,567	3.1	99,670	5.3	8,318	0.3
其他收益/(虧損)，淨額	116,747	4.5	(37,773)	(1.1)	39,122	1.0	5,896	0.3	46,966	1.9
經營(虧損)/利潤	(531,700)	(20.5)	(718,436)	(21.2)	(415,627)	(10.9)	(248,743)	(13.1)	15,231	0.6
財務收入	46,486	1.8	53,020	1.6	67,944	1.8	31,872	1.7	28,646	1.2
財務成本	(2,380)	(0.1)	(4,109)	(0.1)	(5,991)	(0.2)	(2,042)	(0.1)	(8,380)	(0.3)
財務收入淨額	44,106	1.7	48,911	1.4	61,953	1.6	29,830	1.6	20,266	0.8
應佔一間聯營公司淨利潤	939	0.0	7,730	0.2	3,037	0.1	1,837	0.1	19,705	0.8
所得稅前(虧損)/利潤	(486,655)	(18.7)	(661,795)	(19.5)	(350,637)	(9.2)	(217,076)	(11.4)	55,202	2.3
所得稅(開支)/抵免	(19,166)	(0.7)	(31,219)	(0.9)	(39,648)	(1.0)	(28,328)	(1.5)	29,042	1.2
年度/期間(虧損)/利潤	(505,821)	(19.5)	(693,014)	(20.5)	(390,285)	(10.2)	(245,404)	(12.9)	84,244	3.4

非國際財務報告準則計量

為補充按國際財務報告準則會計準則編製之合併財務報表，我們採用經調整淨(虧損)/利潤(非國際財務報告準則計量)作為額外財務衡量指標。該指標並非國際財務報告準則會計準則所要求，亦非按國際財務報告準則會計準則呈報。我們認為非國際財務報告準則計量通過剔除管理層認為不代表我們經營表現之項目之潛在影響，有助各期及公司間經營表現的比較。我們相信該指標可協助投資者及其他人士以管理層所用之相同方式理解及評估我們的經營業績。然而，我們所呈列之經調整淨(虧損)/利潤(非國際財務報告準則計量)未必可與按類似名稱呈列之其他公司指標直接比較。非國際財務報告準則計量作為分析工具存在局限，閣下不應將其脫離或替代我們按國際財務報告準則會計準則呈報之經營業績或財務狀況分析。

我們將經調整淨(虧損)/利潤(非國際財務報告準則計量)定義為年度/期間(虧損)/利潤，經加回以下項目調整後得出：我們股權激勵計劃產生的，以權益結算的股份支付費用。任何特定期間的此類開支預計不會導致未來現金支付，且不能表明我們的核心經營成果。下表載列經調整淨(虧損)/利潤(非國際財務報告準則計量)與按照國際財務報告準則會計準則呈列的年內/期內(虧損)/利潤之間的差異及相關調整項目：

概 要

	截至12月31日止年度			截至6月30日止六個月	
	2023年	2024年	2025年	2025年	2026年
	(以人民幣千元計)			(未經審計) (未經審計)	
年度／期間（虧損）／利潤	(505,821)	(693,014)	(390,285)	(245,404)	84,244
加：					
以股份為基礎的薪酬開支	10,710	176,274	127,134	76,715	35,868
經調整淨（虧損）／利潤（非國際財務報告準則計量）	<u>(495,111)</u>	<u>(516,740)</u>	<u>(263,151)</u>	<u>(168,689)</u>	<u>120,112</u>

收入

於往績記錄期間，我們的收入主要來自自有品牌產品銷售，其次為ASIC定制解決方案提供。下表載列所示期間我們按產品及服務類型劃分之收入明細（含絕對值及佔我們收入總額之百分比）：

	截至12月31日止年度						截至6月30日止六個月			
	2023年		2024年		2025年		2025年		2026年	
	人民幣	%	人民幣	%	人民幣	%	人民幣	%	人民幣	%
	(以人民幣千元計，百分比除外)						(未經審計) (未經審計)			
自有品牌產品	2,246,293	86.4	3,013,761	89.0	3,579,331	93.8	1,753,622	92.4	2,113,622	86.2
—無線連接芯片	1,562,666	60.1	2,483,501	73.4	3,007,896	78.8	1,524,544	80.3	1,894,990	77.3
—智能SoC	683,627	26.3	530,260	15.6	571,435	15.0	229,078	12.1	218,632	8.9
ASIC定制解決方案 ⁽¹⁾	226,262	8.7	335,728	9.9	217,222	5.7	126,232	6.7	321,903	13.1
其他 ⁽²⁾	127,361	4.9	36,254	1.1	20,250	0.5	18,212	0.9	15,750	0.7
總計	<u>2,599,916</u>	<u>100.0</u>	<u>3,385,743</u>	<u>100.0</u>	<u>3,816,803</u>	<u>100.0</u>	<u>1,898,066</u>	<u>100.0</u>	<u>2,451,275</u>	<u>100.0</u>

- (1) 我們一般於ASIC定制項目完成及交付時確認收入，我們該項服務於某一期間的收入很大程度取決於該期間達到交付及收入確認階段的项目數量，而非我們的整體業務活動規模。
- (2) 主要包括向來自(i)獨立半導體IP授權及(ii)向EDA供應商提供芯片測試及驗證服務的收入。該等活動屬我們主營業務的輔助性質，並非我們業務發展的重點。因此，該等收入的金額及時間屬非經常性，且在較大程度上取決於相關客戶自身的產品開發及評估時間表。

下表列示了我們所示期間按產品類型劃分的自有品牌產品銷售量和平均售價：

	截至12月31日止年度						截至6月30日止六個月			
	2023年		2024年		2025年		2025年		2026年	
	銷量	平均售價	銷量	平均售價	銷量	平均售價	銷量	平均售價	銷量	平均售價
	(人民幣 千件)		(人民幣 千件)		(人民幣 千件)		(人民幣 千件)		(人民幣 千件)	
無線連接芯片	124,119	12.6	213,189	11.6	301,713	10.0	161,485	9.4	168,292	11.3
智能SoC	31,943	21.4	29,028	18.3	29,264	19.5	11,185	20.5	10,586	20.7

概 要

於往績記錄期間，我們無線連接芯片的銷量持續增加，主要受益於我們持續推出新產品以及不斷拓展蜂窩連接芯片的下游應用場景。我們的智能SoC銷量於2023年至2025年有所波動，主要反映我們的智能SoC產品組合由上一代產品過渡至新一代產品（如我們的八核及AI智能手機SoC）。隨着上一代產品的出貨量逐步下降，我們的新一代產品經歷客戶設計導入、認證及產量爬坡，而該等過程通常需時較長，加上客戶自身產品推出及採購的時間安排，亦對我們各期間的出貨量造成影響。我們的智能SoC銷量由截至2025年6月30日止六個月至截至2026年6月30日止六個月有所下降，主要由於存儲器價格上升抑制了下游市場的需求。

從2023年至2025年，我們的無線連接芯片的平均售價整體呈下降趨勢，主要反映我們不斷推出價格更為親民的新產品，以順應不斷變化的市場需求。截至2025年6月30日止六個月至截至2026年6月30日止六個月，平均售價其後有所上升，主要歸因於我們的高端產品如5G芯片產品在客戶採用率持續提升及市場需求增長的推動下，銷售貢獻有所增加，而該等芯片的平均售價較高。

我們的智能SoC平均售價於2023年至2025年出現波動，主要反映我們產品組合的變動。我們的智能SoC平均售價於截至2025年及2026年6月30日止六個月分別保持相對穩定。

毛利及毛利率

於2023年、2024年、2025年以及截至2025年及2026年6月30日止六個月，我們分別錄得毛利人民幣584.4百萬元、人民幣695.8百萬元、人民幣890.7百萬元、人民幣405.9百萬元及人民幣699.5百萬元；所示期間的毛利率分別為22.5%、20.5%、23.3%、21.4%及28.5%。下表載列所示期間按產品及服務類型劃分的毛利及毛利率：

	截至12月31日止年度						截至6月30日止六個月			
	2023年		2024年		2025年		2025年		2026年	
	毛利	毛利率	毛利	毛利率	毛利	毛利率	毛利	毛利率	毛利	毛利率
	人民幣	%	人民幣	%	人民幣	%	人民幣	%	人民幣	%
(以人民幣千元計，百分比除外)										
							(未經審計)		(未經審計)	
自有品牌產品	443,527	19.7	610,850	20.3	857,645	24.0	419,054	23.9	585,229	27.7
— 無線連接芯片	316,179	20.2	501,785	20.2	711,167	23.6	362,103	23.8	517,874	27.3
— 智能SoC	127,348	18.6	109,066	20.6	146,478	25.6	56,951	24.9	67,355	30.8
ASIC定制解決方案	66,341	29.3	136,925	40.8	71,740	33.0	30,963	24.5	118,744	36.9
其他 ⁽¹⁾	113,170	88.9	35,703	98.5	19,897	98.3	17,873	98.1	15,636	99.3
小計	623,038	24.0	783,479	23.1	949,282	24.9	467,890	24.7	719,609	29.4
存貨減值損失	(38,630)	不適用	(87,711)	不適用	(58,602)	不適用	(62,007)	不適用	(20,117)	不適用
總計	584,408	22.5	695,768	20.5	890,680	23.3	405,883	21.4	699,492	28.5

- (1) 主要指(i)獨立半導體IP授權，及(ii)向EDA供應商提供芯片測試及驗證服務。該等活動屬我們主營業務的輔助性質，並非我們業務發展的重點。因此，該等收入的金額及時間屬非經常性，且在較大程度上取決於相關客戶自身的產品開發及評估時間表。

概 要

於往績記錄期間，我們不同產品及服務線的毛利率各有差異。我們的ASIC解決方案的毛利率一般高於自有品牌產品，主要原因為該等解決方案乃按照客戶特定需求定制，且涉及設計及開發服務。與此同時，由於該等解決方案按個案基準定價，其毛利率會隨交付項目的組合不同而可能出現較大波動。在我們的自有品牌產品當中，無線連接芯片與智能SoC的毛利率存在差異，反映產品組合的差異。我們的其他收入的毛利率大幅偏高，原因是相關業務本質上屬服務及授權業務，其成本架構與芯片產品存在較大差異。我們的整體毛利率受各產品及服務線的收入貢獻佔比，以及相關產品的平均售價及單位成本的變動所影響。此外，我們的存貨減值損失於往績記錄期間出現波動，主要由於若干期間為應對相關下游終端市場的需求變化而確認了較大的一次性減值撥備。

合併資產負債表概要

下表載列我們於所示日期的合併財務狀況表明細：

	截至12月31日			截至6月30日
	2023年	2024年	2025年	2026年
	(人民幣千元)			(未經審計)
非流動資產	901,471	1,063,652	1,136,659	1,434,692
流動資產	6,397,081	5,473,216	5,843,560	6,359,266
流動負債	801,004	740,242	1,360,488	1,802,512
流動資產淨值	5,596,077	4,732,974	4,483,072	4,556,754
非流動負債	141,995	114,849	161,902	147,367
負債總額	942,999	855,091	1,522,390	1,949,879
資產淨值	<u>6,355,553</u>	<u>5,681,777</u>	<u>5,457,829</u>	<u>5,844,079</u>

我們的流動資產淨值由2023年12月31日的人民幣5,596.1百萬元減少至2024年12月31日的人民幣4,733.0百萬元，主要由於(i)按公允價值計入損益的金融資產減少，乃由於我們於年內將到期結構性存款贖回，並將所得款項主要用於撥付經營活動及股份回購；及(ii)程度較輕者為存貨減少，原因為我們優化了採購規劃及存貨水平。該減少部分被預付款項、其他應收款項及其他資產以及貿易應收款項的增加所抵銷，該等增加與同期我們的採購增加及銷售增長大致相符。

我們的流動資產淨值進一步減少至截至2025年12月31日的人民幣4,483.1百萬元，主要由於若干流動負債項目增加，主要包括(i)銀行借款，我們於年內提取該等借款以滿足營運資金需求；及(ii)其他應付款項及應計費用以及貿易應付款項，主要與2025年訂立的一項新知識產權許可協議以及我們增加原材料採購有關。該減少部分被存貨及向供應商預付款項的增加所抵銷，原因是我們預期客戶需求增長而增加採購。

我們的流動資產淨值略增至截至2026年6月30日的人民幣4,556.8百萬元，主要由於存貨及向供應商的預付款項增加（因我們預期客戶需求增長而進一步增加採購）以及貿易應收款項增加（與期內銷售增長相符）。該等增加部分被(i)合約負債（指就新ASIC定制項目及自有品牌產品訂單收取的預收款項）及銀行借款的增加；及(ii)按公允價值計入損益的金融資產以及現金及現金等價物的減少所抵銷，而該等資金（連同客戶預付款項及銀行借款）已用於撥付我們的運營。

概 要

合併現金流量表概要

下表載列我們於所示期間的合併現金流量表概要：

	截至12月31日止年度			截至6月30日止六個月	
	2023年	2024年	2025年	2025年	2026年
	(人民幣千元)			(未經審計)	(未經審計)
經營活動所用現金淨額.....	(678,328)	(411,525)	(455,717)	(272,133)	(378,051)
投資活動所得現金淨額.....	1,811,058	678,288	520,534	229,046	134,771
融資活動(所用)/所得現金淨額.....	(670,953)	(208,177)	385,882	253,232	191,824
現金及現金等價物增加/(減少)淨額.....	461,777	58,586	450,699	210,145	(51,456)
年/期初現金及現金等價物.....	2,077,403	2,548,226	2,622,214	2,622,214	3,032,094
現金及現金等價物的匯率變動影響.....	9,046	15,402	(40,819)	(5,597)	(65,718)
年/期末現金及現金等價物.....	2,548,226	2,622,214	3,032,094	2,826,762	2,914,920

於往績記錄期間，我們現金的主要用途為採購晶圓、封裝及測試服務及其他材料、研發活動及員工薪酬。於往績記錄期間，我們主要透過手頭現金及現金等價物、按公允價值計入損益的金融資產的淨贖回以及銀行借款所得款項為我們的營運及其他資本需求提供資金。展望未來，我們相信我們的流動資金需求將透過經營活動產生的現金、[編纂]以及不時根據我們需求進行的其他債務及股權融資來滿足。詳情請參閱「財務資料—流動資金及資本資源」。

主要財務比率

下表載列我們於所示日期或所示期間的主要財務比率：

	截至12月31日止年度/截至12月31日			截至6月30日止 六個月/ 截至6月30日
	2023年	2024年	2025年	2026年
毛利率 ⁽¹⁾	22.5%	20.5%	23.3%	28.5%
流動比率 ⁽²⁾	8.0	7.4	4.3	3.5
速動比率 ⁽³⁾	6.1	5.6	3.0	2.3

(1) 毛利率按毛利除以收入再乘以100%計算。

(2) 流動比率按流動資產總值除以流動負債總額計算。

(3) 速動比率按流動資產總值減存貨除以流動負債總額計算。

概 要

股息

於往績記錄期間，本公司並無宣派或派付任何股息。我們目前預計將保留所有未來盈利，用於經營及業務擴張，並預計在可預見的未來不會派付現金股息。未來任何股息的宣派及派付將由股東於股東會決定，並須遵守本公司的組織章程細則及中國公司法，且將取決於多項因素，包括我們的產品能否成功商業化，以及我們的盈利、資本需求、整體財務狀況及合約限制。目前，我們設有具備適當預先確定派息比率的股息政策。經我們的中國法律顧問確認，我們未來產生的任何稅後利潤均須根據中國法律用於彌補歷史累計虧損，其後，我們須將利潤的10%撥入法定公積金，直至該公積金總額達到註冊資本的50%。因此，我們僅可在(i)我們所有歷史累計虧損已獲彌補；及(ii)我們已按上述規定向法定公積金撥入足夠利潤後，方可宣派股息。

未來計劃及[編纂]

經扣除本公司就[編纂]應付的[編纂]佣金、費用及估計開支後，我們估計[編纂]約為[編纂]港元（假設[編纂]為每股[編纂][編纂]港元（即[編纂]），且[編纂]未獲行使）。

我們擬將[編纂]用作以下用途：(i)約[編纂]%（或[編纂]港元）將用於提升我們的研發能力及擴充產品組合；(ii)約[編纂]%（或[編纂]港元）將用於推動長期增長策略的戰略投資或收購；(iii)約[編纂]%（或[編纂]港元）將用於拓展銷售網絡，並提升我們的銷售及營銷能力；及(iv)約[編纂]%（或[編纂]港元）將用作營運資金及其他一般企業用途。詳情請參閱「未來計劃及[編纂]」。

我們的單一最大股東集團

根據戴先生、寧波捷芯、Great ASR1及Great ASR2於2020年9月訂立的一致行動協議，彼等已承諾就本公司的營運及重大決策採取一致行動。戴先生擁有全權酌情權指示行使彼等所持股份附帶的全部表決權。

截至最後實際可行日期，戴先生直接及透過寧波捷芯、Great ASR1及Great ASR2間接控制本公司約22.32%的表決權。在[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使，且自最後實際可行日期至[編纂]期間本公司已發行股本並無其他變動），戴先生直接及透過寧波捷芯、Great ASR1及Great ASR2間接將控制本公司約[編纂]%的表決權。因此，戴先生、寧波捷芯、Great ASR1及Great ASR2於[編纂]時為並將繼續為本公司的單一最大股東集團。

概 要

A股於上海證券交易所上市

於2022年1月14日，本公司的A股於上海證券交易所科創板上市（上交所：688220）。我們的董事確認，自我們於上海證券交易所上市之日起至最後實際可行日期，我們在任何重大方面均未發生違反上海證券交易所規則及中國其他適用證券法律法規的重大違規行為，且據董事進行一切合理查詢後所知，就我們於上海證券交易所的合規記錄而言，不存在應提請投資者注意的重大事項。我們的中國法律顧問認為，上述董事有關我們合規記錄的確認準確。基於聯席保薦人進行的獨立盡職審查，聯席保薦人並不知悉任何導致彼等不同意董事有關本公司於上海證券交易所合規記錄確認的事項。

[編纂]

[編纂]

[編纂]

[編纂]

[編纂]

[編纂]

概 要

[編纂]

法律程序及合規

我們的董事經其中國法律顧問告知後確認，於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們已在所有重大方面遵守相關中國法律法規。於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們並無遭受任何將對我們的財務狀況或整體經營業績造成重大不利影響的申索、損害或損失。

[編纂]

[編纂]

近期發展及無重大不利變動

我們的董事已確認，截至本文件日期，自2026年6月30日（即我們最近期經審計財務報表的結算日）以來，我們的財務或貿易狀況或前景並無重大不利變動，且自2026年6月30日以來，並無發生任何將對本文件附錄一所載會計師報告所載資料造成重大影響的事件。